

2024年2月28日
株式会社ADEKA

先端半導体向け新規材料の製造棟を新設

株式会社ADEKA（代表取締役社長兼社長執行役員：城詰 秀尊、本社：東京都荒川区）は、次世代半導体向け新規材料の量産体制構築に伴う生産スペースの確保を目的に、連結子会社であるADEKA KOREA CORPORATION 全州第三工場内に、製造棟を新設することを決定しました。

5G通信やAIの活用拡大などの高度ICT社会の実現には、半導体が必要不可欠です。半導体は、情報処理の高速化や消費電力の低減を背景とした微細化による高集積化が進行しており、これを下支えする先端材料のニーズが高まっています。

ADEKAグループ中期経営計画『ADX 2023』（2021-2023年度）では、「次世代ICT分野」を重要分野の一つと位置付け、先端半導体材料を中心に積極的に投資を実行しており、日本・韓国・台湾における研究開発ならびに生産体制の構築を推し進めてまいりました。

特にADEKA KOREA CORPORATION（以降、同社）では、世界シェアNo. 1^{*}を誇る先端半導体メモリ向け高誘電材料「アデカオルセラ」シリーズの増産と製品ラインナップ拡充のための積極的な設備投資を進めています。今後も微細化に欠かせない製品群として、次世代半導体デバイス量産化の際に新規材料をいち早く安定供給するために、短い工期で量産体制を整える必要があることから、製造棟を新設する運びとなりました。

なお、製造棟を新設する場所は、2022年に用地を取得した同社全州第三工場となります。これまで先端半導体材料は、主に全州第二工場で製造しておりますが、今回新たに全州第三工場に製造棟を建設します。同製造棟では、次世代以降DRAM向けおよび次世代ロジックおよびNAND向け材料を量産予定です。

ADEKAグループは、主力製品である半導体メモリ向け材料の拡大はもとより、ロジック半導体向けへと領域拡大を推し進め、世界トップの半導体材料メーカーを目指してまいります。

※1 富士キメラ総研「2020年 半導体材料市場の現状と将来展望」より。

■ 概要

所在地	ADEKA KOREA CORPORATION 全州第三工場（韓国 全羅北道 完州郡）
投資金額/延床面積	非開示
製造予定製品	次世代以降DRAM向け新規材料、次世代ロジックおよびNAND向け材料
スケジュール	完工：2024年9月（予定）

以上

■ 本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社ADEKA 法務・広報部 総務・広報グループ

Tel:03-4455-2803/E-mail: somu@adeka.co.jp